AIチップ、イメージセンサ: Insta360 X6 アクションカメラ搭載IC 構造解析レポート(企画)



Insta360 X6



トリプルAIチップシステム

https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x6

レポート概要

アクションカメラ（ウェアラブルカメラ)は、主にスポーツやアウトドアなどの激しい動きや過酷な環境での撮影に特化したカメラです。

Insta360は2014年に設立され、全天球VR(360度)カメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

2026年8月、そのInsta360はInsta360Xの最新シリーズ「Insta360 X6」を発売しました。同カメラは、前モデルのX5と比較してセンサーの大型化(33%)、業界唯一のトリプルAIチップ構成で、メインのチップをQualcomm製4nm(X5はAmbarella製5nm※)に刷新し、処理性能向上、クロック速度高速化を図っています。

今回、 X6搭載のAIチップ、イメージセンサについての構造解析レポートを企画しています。

※ Insta360 X5搭載AIチップのレポート(25G-0490-1,2)は販売中です。

製品特徴

型番： Insta360 X6　360度カメラ　製品リリース日：2026年8月

・Sonyのカスタムセンサー搭載(デュアルセンサー)
・トリプルAIチップシステム採用
　(Qualcomm 4nmフラッグシップチップ1基とプロイメージングチップ2基)

解析内容＆レポート価格

① Qualcommチップ構造解析レポート：　予定価格￥900,000（税別）　企画成立後 2ヶ月

②プロイメージングチップ構造解析レポート：予定価格￥700,000（税別）　企画成立後 2ヶ月

・チップ観察
・断面解析(ロジック部でのプロセス確認)
・平面レイアウト確認 (各機能ブロック面積算出、メモリ容量、ゲート規模算出)
・機能推定

③センサーIC構造解析レポート：　予定価格￥1,450,000（税別）　企画成立後 2ヶ月

・画素部平面解析：画素部レイアウト、画素部等価回路作成
・回路部平面解析：各機能ブロック面積算出、メモリ容量、ゲート規模算出
・断面解析(ロジック部でのプロセス確認)

Report No：26L-0432-1,2,3　Release day：未定

株式会社エルテック
〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡 4丁目42-8 TEL.072-787-7385
mail contact2@ltec-biz.com
HP https://www.ltec-biz.com/

Insta360 X6とX5の比較

項目	Insta360 X5（前モデル）	Insta360 X6
発売時期	2025年	2026年8月
センサーサイズ	1/1.28インチ	1/1.1インチ
最大360度動画	8K／30fps	8K／50fps（動きに強く スロー対応）
最大フラット 動画	4K／60fps	5K／60fps、4K／120fps
最大360度写真	7200万画素（72MP）	1億2000万画素（120MP）
チップ構成	トリプルAIチップ	トリプルAIチップ
	Ambarella製5nm ×1	Qualcomm製 4nm ×1
	Proイメージングチップ ×2	Proイメージングチップ ×2
Wi-Fi転送速度	Wi-Fi 5（ 最大31MB/秒）	Wi-Fi 6（ 最大100MB/秒）
内蔵ストレージ	なし	64GB
防水性能	本体防水 15m	本体防水 20m

Report No：26L-0432-1,2,3　Release day：未定

株式会社エルテック
〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡 4丁目42-8 TEL.072-787-7385
mail contact2@ltec-biz.com
HP https://www.ltec-biz.com/